

# Two part thermal gel pad / XK-S15

## Features:

- 1:1 mix
- (no cure by-product)
- Low stress applications
- Easy to use
- Fast cure by heating



## Applications

- Automotive electronics
- Telecommunications
- Computer&peripherals
- Thermally conductive & vibration dampening
- Between any heat-generating semiconductor and a heat sink

	<b>XK-S15</b>	<b>METHOD</b>	<b>UNIT</b>
Color / Part A	White	Visual	
Color / Part B	Yellow	Visual	
Features	Soft gel	-	-
Density	2.0	ASTM D792	g/cm3

### Before Cured Property

A:B	1:1	-	-
Viscosity@25°C	280	ASTM D2196	Pa.s
Shelf Life @ 25°C	6		month

### After Cured Property

Color	Yellow	Visual	-
Cure Schedule 1	6 hrs/25°C		
Cure Schedule 2	40 min/80°C		
Cure Schedule 3	10 min/100°C		
Working time	120 min/25°C		
Hardness	60	ASTM D2240	Shore 00
	30	JIS K7312	AskerC
Tensile Strength.	0.3	ASTM D412	Mpa
Elongation	>50	ASTM D412	%
Continuous Use Temp	-40~150		°C

### Electrical Property

Dielectric strength	>10	ASTM D149	KV/mm
Volume resistivity	>10 <sup>12</sup>	ASTM D257	Ohm-cm
Dielectric Constant	5	ASTM D150	(1KHz)
Flame Rating	V-0	UL94	

### Thermal Property

Thermal Conductivity	1.5	ASTM D5470	W/m*K
Heat Capacity	1	ASTM E1269	J/g-K

## 使用操作程序:

1. AB 比例 1:1 , AB 胶两剂要混合均匀
2. 使用工具: 自动点胶机 或 手动供料枪
3. 熟化时间与点胶量(成品厚度) 有关

Curing temperature °C	Curing time
25	20 hr
50	120~300min
80	20~100min
100	10~20min
150	1~3 min

### 注意要点

#### 接触面:

如果与含硫磺,磷,氮气化物,氮及含有机金属盐等物质接触时,阻害其表面硬化,轻微者阻害其表面与接触面的硬化,严重者造成永久,完全性不硬化.

#### 环境面:

除要求混合比例之正确外,在混胶使用之容器(如:纸杯,塑料杯...),因为容器内壁之油脂,塑料中可塑剂的渗透关系,烤箱内部因为烘烤过环氧树脂,凡立水..等,会造成污染

因此在使用之前,清扫并干燥机器,特别是与上述物质有接触可能,请先行做试验

### 保存方法

1. 保存方式,在未混合使用前,室温 25 度 C 以下可保存 12 个月
2. AB 剂混合后需一次用完,无法留至日后继续使用